⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-237385

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)10月22日

H 01 T 13/39

7337-5G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称 点火プラグ

> ②符 顧 昭60-75458

頤 昭60(1985)4月11日 29出

紬 砂発 明·者 吅 Ш 和憲 砂発 眀 老 B f 明 者 砂発

舎 題 博

日本特殊陶業株式会社 弁理士 藤木 三幸 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内

名古屋市瑞穂区高计町14番18号

1. 発明の名称

砂出

20代 理

願 人

点火プラグ

2.特許請求の範囲

- (i) Ni 合金よりなる母材に、高温耐食性の良好 な金属およびまたはその金属の合金よりたる粉末 層を介して、貴金属またはその合金よりなるテッ ブを接合する電極を具える点火ブラグ。
- (2) 高温耐食性の良好な金属かよびその合金は、 貴金属およびその合金である特許請求の範囲第1 項記載の点火プラグ。
- (3) 高温耐食性の良好な金属は、INC 6 000。 SuS 310 等の金属合金である特許請求の範囲第 1項記載の点火プラグ。
- (4) 金属およびその合金の粉末層の粉末粒径は 1~20 μである特許請求の範囲第1項配徴の点 火ブラグ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、特に内燃機関用の耐久性を向上さ せた電極をもつ点火プラグに関する。

(従来の技術)

従来、耐久性の向上を目的として、 INC 600 のような耐熱Ni合金材を母材とする中心電極先端 に貴金属チップを啓接した点火プラグは知られて いるが、先端部の温度が900℃を越える高温下 ての使用、特に冷熱サイクルの繰り返しを受ける 場合は、母材と貴会属との熱膨張差による熱応力 により、両者の袋合境界において危裂と酸化侵食 の進展が発生し、先端貴金属と母材材質の組合せ により程度はあるが、おおむね貴金属チップの火 花消耗による消放以前に耐久性が限界に達するも のである。

(発明が解決しようとする問題点)

との発明は上配従来のものの欠点を改良するも のであり、貴金属チップと母材との接合力を高め、 点火ブラグの耐久性を向上させようとするもので

(問題点を解決するための手段)

そのために、点火ブラグの電極(中心電極もしくは外側電極)をNi合金よりなる母材に高温耐食性の良好な金属かよびまたはその金属の合金よりなる粉末層を介して黄金属またはその黄金属合金のチップを接合してなるものである。

なか、上記粉末層の厚みは 0.05 ~ 0.20 mmが適当であり、その粉末粒径は 1 ~ 20 mmが適当であり、その粉末粒径は 1 ~ 20 mmが適当であり、その粉末の機合は、溶接の勝粉末の場合は、溶液を制符できる中間層の形成が困難であり、また合強度が保証の粉末の場合には、中間層として接合強度が保証の溶液により接合強度が劣化するものである。更に粉末材料としては、貴金属材質と同一材の粉末が良好であるが、1000で以上の耐酸化性を具える材料、例えば、貴金属としてPtーNi合金、PtーIr,PtーPd,PtーRh、貴金属以外においては、INC 6 0 1 , SuS 3 1 0 (2.0 Ni - 25 Cr) 体である。

(7)は、母材(1)とチップ(5)を金属粉末(4)層を介して 挟持し、超音波溶接あるいは抵抗溶接をするため の電極板である。

まず、INC 600 の母材(1)上に穿孔工具(3)により有底孔(2)を設け(a)、この有底孔(2)内に、Pt-20Irの1~20 年粒径の粉末(4)を充填し(b)、これをプレスピン(6)により押圧圧縮した上(c)、Pt-20 Irよりたる貴金属テップ(5)を軟量して電極板(7)(7)間に挟持し、通電して、抵抗再接をするものである。通電により母材(1)に上記テップ(5)は粉件層の溶融により接合され、この母材(1)は第2図に示されるように主体金具(8)の嫡面に取付けられる。(9)は中心電板であり、40は絶縁体を示す。

上記のようにして構成される貴金属チップ(5)の 接合状態は電気炉における加熱 3 分(最大 1000C)、 放待 3 分(最低 300C)熱冷サイクルの 500 回の試 験結果は、第 3 図に示すように、チップ(5)が従来 のように電極母材(1)に直接に Pt-20Ir のみを溶接 した場合には接合間隙(a)は(a)に示されるとおり比 較的大きくなり、チップ接合状態は小面積となる (作用)

上記のように構成するため、母体と貴金属テップ間の熱応力を緩和しその接合が良好であり、しかも、高温耐食性に富む粉末材料の落融により上記チップを母材に接合しているため、冷熱サイクルに対し、急裂発生により破損するおそれがない。

(実施例)

これを図に示す実施例により説明すれば、第1 図は、製造工程の概略を(a) ~ (d) により示したものであり、図においては外側電極について記載しているが、中心電極の発火部に適用できることはいりまでもない。(1) は電極材であり、INC 600 より構成する。(2) は、母材(1) 先端に穿設する直径が1.2 mmがで深さ(t)が0.05~0.2 mmの有底孔であって、(3) は穿設工具である。(4) は有底孔(2) 内に遺立先機される金属粉末であり、実施例においてはな種1~20×0 Pt-20 Ir よりなる直径が1.2 mm がで厚さが0.4 mmの貴金属チップであつて、(6) は充填金属粉末を圧縮するためのブレスピン、(6) は充填金属粉末を圧縮するためのブレスピン、

ものであるが、との発明の実施例のように 1~20点 の粒径のPt~20Ir 粉末磨 0.05~0.2 mm を介在した場合には、接合面が大面積であり、関数(a)が小部分であることが明らかである。

(発明の効果)

以上のとおり、従来の点火ブラグに比べ、奇路な冷熱サイクルにあつても発火部に損傷を生じない等、耐久性を向上する優れた効果を具えるものである。

4. 図面の簡単な説明

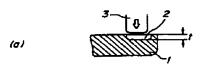
第1図(a)~(d)はこの発明の電極製造工程を示し、 第2図はこの発明の電極を具える点火プラグの部 分図、第3図は従来のものとの比較図を示す。

1 … 饱極母材、 2 … 有底孔、 4 … 金属粉末、

5 … 黄金属チップ

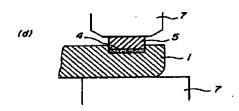
特許出版人 代職人 弁理士 藤 木 三 幸

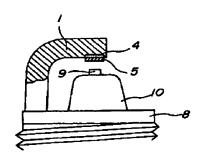












第3図

